

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2024年3月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

| | |
|------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | 3月5日 10:00-11:00, 14:00-15:00, 15:30-16:30 国海证券、永赢基金、华泰证券、交银电子、高盛证券、中欧基金、中邮证券 3月19日 11:45-12:45, 18:30-19:30 香港盛博、Hotchkis And Wiley Capital Management、DE Shaw、HCEP Management、Franklin Templeton Sealand Management、Invesco Hong Kong、Springs Capital (Hong Kong)、Pictet Asset Management、Bernstein、巴克莱银行、Artisan Partners、Colorado PERA、Polar Capital、SCGE Management、Walleye Capital |
| 时间 | 3月5日 10:00-11:00, 14:00-15:00, 15:30-16:30 3月19日 11:45-12:45, 18:30-19:30 |
| 地点 | 无锡、上海 |
| 上市公司接待人员姓名 | 吴国屹 华润微电子执行董事、财务总监兼董秘 沈筛英 华润微电子董事会办公室副主任 |

| | |
|---------------------------|--|
| <p>投资者关系活动 主要内容介绍</p> | <p>一、公司 2023 年经营情况简介</p> <p>1. 主要财务指标：</p> <p>根据公司 2023 年度业绩快报，报告期内公司实现营业收入 99.01 亿元，实现利润总额 16.87 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 14.80 亿元；报告期末公司总资产为 292.18 亿元；归属于母公司所有者权益为 215.59 亿元。</p> <p>在行业景气度下行调整阶段，公司积极布局重大项目，两条 12 吋线、封测基地等新业务逐步开展；同时加大研发投入力度，不断推出适应市场需要的新技术和新产品，整体业绩跑赢大市。</p> <p>2. 2024 年业绩指引：</p> <p>公司预计 2024 年营业收入在 2023 年的基础上可实现 10-20% 的增长；毛利率目标保持在 30% 以上。</p> <p>二、投资者的主要问题</p> <p>问题一：请问公司订单情况和趋势？</p> <p>答：公司在消费、工业设备、新能源等细分领域订单量有所增长，目前订单可见度在 3 个月左右。公司与客户整体合作进展顺利，行业处于回暖趋势，对于后续订单保有信心。</p> <p>问题二：请问公司目前封装的产能情况及后期规划？</p> <p>答：公司目前封装能力月产能 8.7 亿颗。封装板块覆盖功率半导体产品模块封装、晶圆中道生产线、面板级封装、第三代半导体封装等技术领先门类。封测业务作为公司 IDM 商业模式的重要组成部分，积极做先进封装布局，更好地为内部客户提供高性能、高可靠的封装服务，提高公司产品附加值。</p> |
|---------------------------|--|

问题三：请问公司深圳 12 吋项目的建设进展及未来规划？

答：深圳 12 吋项目主体厂房已于去年建设完成，将逐步进入设备移入安装阶段；同步推进研发工作，研发团队已围绕 12 吋产线开展工艺的产品设计及预研工作。预计 2024 年年底实现通线投产，满产后将形成年产 48 万片 12 吋功率 IC 芯片的生产能力。

问题四：请问公司 2024 年一季度晶圆制造产能利用率及代工价格表现如何？

答：受到春节及动力检修的影响，公司 6 吋产能利用率保持在 90%左右，8 吋产能利用率在 80%以上，12 吋上半年仍在爬坡阶段，目前投料处于满载状态。代工价格会根据重点客户新产品导入情况及市场状况做动态调整。

问题五：请问公司产能利用率使用保持较高水平的原因？

答：一是得益于公司前几年新产品、新技术的开发及布局；二是客户优质、关系稳定，很多重要客户均有定制化工艺开发；三是公司 IDM 模式具有调节作用。

问题六：请问公司在汽车领域的布局？

答：公司全面拓展汽车电子市场，车规级产品不断丰富，已进入比亚迪、吉利、一汽、长安、五菱等重点车企，其中第三代半导体碳化硅产品获得知名车企的头标。

问题七：请问公司第三代半导体今年预期及目前进展？

答：2024 年公司第三代半导体可达到上亿平台。其中，碳化硅产品包括 SiC MOSFET、SiC JBS 以及 SiC 模块产品，SiC MOSFET 在销售中的比例提升至 50%以上，在新能源汽车、充

| | |
|----------|---|
| | <p>电桩、光伏储能、工业电源等领域规模上量；氮化镓产品在通讯、工控、照明和快充等领域实现多家行业头部客户合作。</p> <p>问题八：目前公司是否在培养国产设备材料的供应体系？</p> <p>答：公司高度重视设备、材料的国产化进程，积极推进国内核心供应商的培养，加快国产化验证，支持国内半导体产业上下游协同发展。</p> <p>问题九：请问公司是否有算力相关产品？</p> <p>答：公司有中低压 MOS 等功率半导体产品可应用于算力领域的服务器或 PC 等。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024 年 3 月 |